TEL

第61期

報　告　書

2023年4月1日から
2024年3月31日まで

東京エレクトロン株式会社
証券コード 8035

東京エレクトロンの基本理念・経営理念

基本理念

基本理念は、東京エレクトロンの存在意義、社会的使命を定義したものです。企業活動の拠り所となる最も基本的な考え方です。

最先端の技術と確かなサービスで、
夢のある社会の発展に貢献します

経営理念

経営理念は、基本理念を実現するために、東京エレクトロンが大切にする経営の規範を8つの項目で明示したものです。

■ 利益について

社会や産業の発展に貢献すべく、利益の追求を重視し企業価値の向上を目指します。

■ 成長について

技術革新に常に挑戦し、事業拡大と市場創出により継続的な成長を図ります。

■ 社員について

社員は価値創出の源泉であり、創造性と責任感と強いチームワークで情熱をもって業務に取り組みます。

■ 安全と健康と環境について

事業に関わるすべての人々の安全と健康、および地球環境への配慮を第一に考えて行動します。

■ 事業分野について

エレクトロニクスを中心とする最先端技術分野において、高品質な製品を提供し市場をリードします。

■ 品質とサービスについて

顧客の満足と信頼を得るために真のニーズを理解し、品質とサービスの向上に努めます。

■ 組織について

個々の能力を最大限に発揮し、企業価値を最大化する最適な組織を築きます。

■ 企業の社会的責任について

企業としての社会的責任を自覚し、社会から高く評価され社員が誇りを持てる企業であるよう心がけます。

目次

事業報告
1. 当社グループの現況に関する事項 …… 3
2. 会社役員に関する事項 …… 10
3. 会社の体制及び方針 …… 22

連結計算書類
連結貸借対照表…… 23
連結損益計算書…… 24

株主メモ…… 25
（ご参考）半導体製造プロセス …… 26

以下の事項につきましては、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「第61期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」をご覧ください。

事業報告
- 当社グループの現況に関する事項
  - 事業の経過及び成果
  - 当社グループの財産及び損益の状況の推移
  - 従業員の状況
  - 主要な借入先
  - 主要な事業所
- 会社の株式に関する事項
- 会社の新株予約権等に関する事項
- 会計監査人の状況
- 会社の体制及び方針
  - 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

連結計算書類
- 連結株主資本等変動計算書
- 連結注記表

計算書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表

監査報告書
- 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
- 会計監査人の監査報告書
- 監査役会の監査報告書

当社ウェブサイト
https://www.tel.co.jp/ir/stocks/asm/

事業報告 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1. 当社グループの現況に関する事項

① 設備投資及び資金調達の状況

当社グループの当連結会計年度に取得した有形固定資産は1,218億4千1百万円となりました。主な設備投資につきましては、以下のとおりであります。

・革新的な技術を備えた高付加価値の製品創出のため研究開発用機械装置等を取得
・技術革新に伴う中長期的な市場成長及び多様化する技術ニーズを見据え、技術開発力のさらなる強化を目的とした新開発棟を建設
　東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱（山梨県）：2023年7月竣工
　東京エレクトロン宮城㈱（宮城県）：2023年6月着工
　東京エレクトロン九州㈱（熊本県）：2023年10月着工
・東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱東北事業所（岩手県）において、生産機能及び物流機能の集約化による生産能力のさらなる向上を目的とした生産・物流棟の建設に2024年2月着工

なお、必要資金につきましては全額を自己資金で賄っており、資金調達について記載すべき事項はありません。

② 対処すべき課題

当社グループは、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、技術革新が速く活発なエレクトロニクス産業の中で、半導体製造装置のリーディングカンパニーとして、ビジネスを積極的に展開しております。

❶ 経営方針

当社グループは、技術専門商社からスタートし、開発製造機能をもつメーカーへの移行、グローバルな販売・サポート体制の構築など、事業環境の変化をいち早く捉え、その変化に素早く応えることにより、世界の市場に高い付加価値をもつ製品・サービスを提供してまいりました。また、当社は、技術革新が新たな価値を生み、継続的な市場拡大が見込まれる事業領域において、時代をリードする独創的な技術を創出し成長を続けてきました。

当社の原動力は、業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力、確かな技術サービスに基づくお客さまからの信頼、そして環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員と、そのチャレンジ精神です。

今後も、当社のもつ専門性と最新技術を活かして事業を推進し、夢と活力のあるワールドクラスの高収益企業を目指すとともに、世の中の持続的な発展を支えるために不可欠な半導体の技術革新に貢献してまいります。

❷ ビジョン

当社グループのビジョンは「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」です。

当社グループは、世の中の持続的な発展を支える半導体の技術革新を追求します。当社の専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

そして、企業の成長は人、社員は価値創出の源泉と位置づけ、ステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、このビジョンの実現に向けて活動してまいります。

❸ 事業環境

情報通信技術の進化とともにデータ社会への移行が進む中、デジタル技術の活用と応用が様々な産業や分野において拡がっています。そして、これを支えるのが半導体の技術革新です。大容量、高速、高信頼性、低消費電力など、半導体の進化に向けた技術の追求は止まりません。トランジスタの誕生から76年。半導体デバイス市場は、2023年に約5,300億ドル(注)1になりましたが、2030年頃には1兆ドル(注)2へと、現在の2倍に相当する高い伸びが見込まれております。当社グループが参入する半導体製造装置事業は、社会の重要インフラである半導体を支え、夢のある社会の発展に向け、今後も大きく成長していくものと予想しております。

（注）1.　世界半導体市場統計（WSTS）　2.　当社による試算

❹ 中長期的な成長を見据えた取り組み

当社グループは、将来の成長と発展を目指すため、2022年6月に、2027年3月期を目標年度とする中期経営計画を発表しました。半導体市場及び半導体製造装置市場の大きな成長が見込まれる中、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を追求するマイルストーンとして、この中期経営計画を位置付けております。

財務目標（2027年3月期まで）	
売上高	≥ 3兆円
営業利益率	≥ 35%
ROE	≥ 30%

また上述の中期経営計画の達成に向けた取り組みに加え、ワールドクラスの利益の創出とさらなる企業価値の向上を目指し、今後5年間の成長投資、人材投資の計画を2024年2月に以下のとおりアップデートいたしました。

・研究開発投資：1.5兆円以上（5年累計）
・設備投資：7,000億円以上（5年累計）
・人材採用：グローバルで10,000人の採用（5年累計）

■人材に関する取り組み

「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」という考えのもと、社員のやる気と会社へのエンゲージメントを重視した経営に取り組んでいます。

社員の能力×やる気：やる気重視経営を推進

01.	自分の会社や仕事が産業や社会の発展に貢献しているという実感	ビジョンの実現
02.	会社の将来に対する夢と期待	中期経営計画を達成
03.	チャレンジできる機会	研究開発投資：1.5兆円以上(5年累計)
04.	成果に対する公正な評価とグローバルに競争力のある報酬	業績連動型報酬
05.	風通しの良い職場	社員集会や座談会の開催

これらを社員と共有するとともに、定期的なエンゲージメントサーベイを進めることにより、社員の高い能力とやる気を引き出し、世の中の持続的な発展を支える半導体の技術革新に貢献することで夢と活力のある会社の維持向上に努めます。

また、将来の成長機会を取り込むために積極的な採用を継続していくとともに、Global、Generation、Genderの3Gの観点を意識しながら、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの向上に取り組んでまいります。そして、組織として膨張ではなく適切な成長を実現するため、業務の効率化、平準化を進め、社員一人一人のワークライフバランスの向上を図るとともに、様々なキャリアパスを示した上で、並行して教育プログラムの充実化を図り、社員の成長を支えてまいります。

加えて、次世代の経営執行を担う人材を育成するため、「TELサクセッションプラン」に基づき後継候補者の育成をおこなっております。指名委員会はその育成状況を分析、精査の上、取締役会に報告するとともに、取締役会は後継者育成プランが適切に実行されるよう監督しております。

社内のこうした取り組みとともに、社外においても将来の半導体人材の育成に取り組んでおります。当社は日米の大学によって構成される「半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ（UPWARDS(注)3）」に参画するなど、様々なプログラムを支援しており、半導体の技術革新をリードする人材育成に寄与することで、半導体産業の発展に貢献してまいります。

（注）3. U.S.-Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors

■環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する取り組み

当社グループは、半導体製造装置のリーディングカンパニーとして、高性能・高品質の製品やサービスの継続的な提供を通じ、より高い利益を上げて経済価値を高めるとともに、サステナビリティに関する取り組みの推進により、持続可能な社会の発展に貢献し社会価値を高めることで経営基盤を強化し、企業価値の向上を図ります。

当社グループのこのような活動は高い評価をうけており、2024年4月に経済産業省と㈱東京証券取引所が創設した「SX(注)4銘柄2024」に選定されました。SXとは、社会と企業のサステナビリティを同期化させ、そのために必要な経営・事業変革をおこない、長期的かつ持続的な企業価値向上を図る取り組みです。当社は、半導体製造装置市場の変化にタイムリーに対応すべく、研究開発、調達・製造、販売、据付・保守サービスなどバリューチェーンにおける全方位的な取り組みをおこなっており、環境負荷対応やサプライチェーンにおけるリスクに適切に対処し、長期にわたり高い業績を上げ、企業価値を向上させてきたことが評価されました。

（注）4.　サステナビリティ・トランスフォーメーション

[環境に関する取り組み]

社会において地球環境保全の重要性がより一層高まる中、当社グループではお客さまやパートナー企業さまと連携し、サプライチェーン全体で半導体の技術革新と環境負荷低減に取り組むことにより、事業リスクの低減や新たなビジネス機会の創出に注力しております。具体的には、E-COMPASS（Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent Solutions）の推進により、様々な活動を展開しております。

・半導体の高性能化と低消費電力化に貢献
・装置のプロセス性能と環境性能の両立
・事業活動全体におけるCO_2排出量の削減

2024年3月期には、環境中期目標についてSBT(注)5の認定を取得し、科学的根拠に基づく目標の確実な達成に努めるとともに、環境長期目標については当初2050年としていたネットゼロの達成時期を2040年へ前倒しし、サプライチェーン全体における温室効果ガスの削減に取り組んでおります。また、気候変動が事業に及ぼすリスクと機会について気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に基づく取り組みを推進し、気候変動に対する継続的な対応策を講じるとともに透明性の高い情報開示をおこなうことで企業としてのレジリエンス（対応力）の向上に努めております。

（注）5.　Science Based Targets。SBTはパリ協定が求める水準と整合した、5年～15年先の目標年として企業が設定する目標

[ガバナンスに関する取り組み]

当社グループは、グローバル競争に勝ち抜き、持続的な成長を果たしていくために、コーポレートガバナンス体制が重要と考えています。常に最適で実効性の高い取締役会と攻めの経営執行体制を構築し、取締役会の実効性評価や機関投資家などからの意見を踏まえた課題に継続的に取り組むことで、中長期的な企業価値向上と持続的成長に向けた強固なコーポレートガバナンス体制

を実現してまいります。

当社グループでは、このような体制や以下に示す取り組みを「攻めと攻めのガバナンス」と称して、実効性の向上に努めております。左側の攻めが短中長期の利益を同時に志向しながら常にワールドクラスの利益率を追求していくことを示しており、右側の攻めがすべての企業活動で不動の基礎をなす「Safety, Quality, and Compliance」、社員をはじめとするステークホルダーとのエンゲージメントやセキュリティの強化・向上を追求することを指しています。

攻めと攻めのガバナンス

ガバナンスの実効性を強化する取り組み

・CEOミッションを社員と共有：短中長期の利益と継続的な企業価値の向上とやる気重視経営の実践
・監査役会設置会社：取締役会及び監査役会から構成される監査役会設置会社とし、監査役会による経営の監督のもと、実効性のあるガバナンスを実現
・取締役会オフサイトミーティングの実施：取締役、監査役及びコーポレートオフィサーによる中長期的な戦略や課題などの議論（年2回）
・CEO報告：取締役会でCEO自ら重要な業務執行状況を報告（毎取締役会）
・代表取締役評価クローズドセッション：代表取締役を除く取締役、監査役及びコーポレートオフィサーによるセッション（年1回）

業務執行を支えるオペレーティングリズム

・コーポレートオフィサーズ・ミーティング：執行側の最高意思決定機関（月1回）
・CSS（Corporate Senior Staff）ミーティング：全業務執行のグローバル横串の連携（年4回）
・四半期レビュー会議：中期経営計画の進捗をモニタリング（年4回）

今後も半導体製造装置市場は高い成長が見込まれます。そのため、当社が事業展開する拠点数も現在の19の国と地域、87拠点から近い将来には100拠点を超えると予想しています。このような中、実効性の高いガバナンスと業務執行を支える効果的なオペレーティングリズムの実現により、短中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を追求してまいります。

❺ 資本市場との対話

当社グループでは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営層が率先してIR（Investor Relations）、SR（Shareholder Relations）活動に取り組んでおります。IR活動においては、四半期ごとの決算説明会や中期経営計画説明会にCEO及び各担当役員が登壇し、事業戦略や成長のストーリーを共有しています。また、CEO直轄組織としてIR専門部隊を設置しており、2024年3月期においては、ニューヨークにIR分室を設けました。これにより北米地域における投資家の皆さまとの対面での対話の機会が増加し、当社グループをはじめ、日本の半導体製造装置業界の認知が広がりました。

❻ 資本政策

当社グループの資本政策は、成長投資に必要な資金を確保し、積極的な株主還元に継続的に取り組み、中長期的成長の視点をもって、適切なバランスシート・マネジメントに努めることを基本としております。具体的には、営業利益率、資産効率をさらに高め、キャッシュ・フローの拡大に努めることで、持続的な成長を目指し、ROE向上など高い資本効率を追求します。

このような資本政策のもと、積極的な株主還元や高水準の成長投資、経営戦略に基づく優秀な人材の確保及び育成、お客さまやお取引先さまとの協業やその成果など、近年の高い利益成長の実績と将来に向けたさらなる成長への期待を背景に、2024年3月末時点の時価総額は東京証券取引所プライム市場で第3位となりました。純資産と比較して時価総額が大きく増加したことで、2024年3月末時点のPBR（株価純資産倍率）は10倍以上の水準となっております。

当社の配当政策につきましては、業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処とします。この方針に基づき、2024年3月期においては、年間配当は393円といたしました。また、自己株式の取得については、現状のキャッシュポジションや中長期的な成長投資資金、株価水準、総還元額の状況などに鑑み、機動的に実施を検討することとしており、2024年3月期については1,199億円の自己株式取得を実施いたしました。

当社グループは、以上のような取り組みを実行することで、さらなる持続的成長と企業価値の向上を通じて、社会に求められ、地球に選ばれる会社として、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念を実践してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、一層のご支援を賜りたく、よろしくお願い申しあげます。

③ 重要な子会社の状況（2024年３月31日現在）

会社名	事業所所在地	資本金	当社の出資比率（間接出資比率）	主要な事業内容
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ㈱	（本社事業所）山梨県 （東北事業所）岩手県	4,000百万円	100 %	半導体製造装置の製造・開発
東京エレクトロン九州㈱	熊本県	2,000百万円	100	半導体製造装置の製造・開発
東京エレクトロン宮城㈱	宮城県	500百万円	100	半導体製造装置の製造・開発
東京エレクトロンFE㈱	東京都	100百万円	100	半導体製造装置等の保守サービス
Tokyo Electron America, Inc.	米国	10米ドル	0 (100)	半導体製造装置等の販売・保守サービス
Tokyo Electron Europe Ltd.	英国	17百万ユーロ	100	半導体製造装置等の販売・保守サービス
Tokyo Electron Korea Ltd.	韓国	6,000百万ウォン	100	半導体製造装置等の販売・保守サービス
Tokyo Electron Taiwan Ltd.	台湾	200百万NTドル	100	半導体製造装置等の販売・保守サービス
Tokyo Electron (Shanghai) Ltd.	中国	6百万米ドル	100	半導体製造装置等の販売・保守サービス
Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.	シンガポール	5百万シンガポールドル	100	半導体製造装置等の販売・保守サービス

（注）当連結会計年度末における連結子会社は、上記各社を含め26社であります。

④ 重要な企業結合等の状況

該当事項はありません。

2. 会社役員に関する事項

① 取締役及び監査役の状況（2024年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況等
代表取締役社長	河合　利樹	CEO
代表取締役副社長	佐々木　貞夫	東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱ 代表取締役会長
取締役	布川　好一	取締役会議長
取締役	佐々木　道夫	㈱SHIFT 取締役副社長
取締役	江田　麻季子	住友商事㈱ 常務執行役員 富士フイルムホールディングス㈱ 社外取締役
取締役	市川　佐知子	田辺総合法律事務所 パートナー オリンパス㈱ 社外取締役 公益社団法人会社役員育成機構 理事
常勤監査役	田原　計志	
常勤監査役	七澤　豊	
監査役	和貝　享介	和貝公認会計士事務所 所長 持田製薬㈱ 社外監査役
監査役	濵　正孝	ニッセイアセットマネジメント㈱ 社外取締役
監査役	三浦　亮太	弁護士法人三浦法律事務所 パートナー テクマトリックス㈱ 社外取締役（監査等委員） エーザイ㈱ 社外取締役

指名委員会委員：佐々木道夫（委員長）、市川佐知子、布川好一
報酬委員会委員：江田麻季子（委員長）、佐々木道夫、布川好一

（注）1. 取締役 佐々木道夫氏、江田麻季子氏及び市川佐知子氏は社外取締役であります。
2. 監査役 和貝享介氏、濵正孝氏及び三浦亮太氏は社外監査役であります。
3. 当社は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性判断基準」を策定しており、取締役 佐々木道夫氏、江田麻季子氏及び市川佐知子氏並びに監査役 和貝享介氏、濵正孝氏及び三浦亮太氏を独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
4. 監査役 七澤豊氏は当社の財務、経理、人事、IT部門などの幅広い分野にわたる豊富な経験を有し、また当社及びグループ会社の管理部門を統括する執行役員や海外現地法人の要職を務めるなど、グローバルな視点でのマネジメント経験も豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役 和貝享介氏は公認会計士として監査法人での長年の経験があり、日本公認会計士協会の常務理事等を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 監査役 濵正孝氏は金融業界における長年の幅広い経験を通じて、企業経営に関する豊富な経験を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
7. 当社は、取締役 佐々木道夫氏、江田麻季子氏及び市川佐知子氏並びに監査役 田原計志氏、七澤豊氏、和貝享介氏、濵正孝氏及び三浦亮太氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務をおこなうにあたり善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
8. 当社は、取締役 河合利樹氏、佐々木貞夫氏、布川好一氏、佐々木道夫氏、江田麻季子氏及び市川佐知子氏並びに監査役 田原計志氏、七澤豊氏、和貝享介氏、濵正孝氏及び三浦亮太氏との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しております。
9. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、当社及び当社子会社の取締役、監査役及びコーポレートオフィサー並びに執行役員その他の従業員を被保険者とし、被保険者が会社の役員等としておこなった業務及び不作為に起因した損害賠償金、和解金、争訟費用等が塡補されます。なお、当該保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。

② コーポレートオフィサー及び執行役員の状況（2024年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当
社長・CEO コーポレートオフィサー	河合　利樹	コーポレートイノベーション本部長
副社長 コーポレートオフィサー	佐々木　貞夫	コーポレート生産本部長 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱ 代表取締役会長
コーポレートオフィサー 専務執行役員	長久保　達也	グローバルビジネスプラットフォーム本部長 内部統制担当、倫理委員長、業務改革プロジェクトリーダー
コーポレートオフィサー 専務執行役員	池田　世崇	アカウントセールス本部長
コーポレートオフィサー 専務執行役員	三田野　好伸	SPE事業本部長
コーポレートオフィサー 専務執行役員	大久保　豪	グローバルセールス本部長、DSS事業本部長
常務執行役員	デビッド・ブラフ	グローバル戦略担当
常務執行役員	ラリー・スミス	グローバル戦略担当
常務執行役員	児島　雅之	東京エレクトロン宮城㈱ 代表取締役会長
常務執行役員	秋山　啓一	後工程事業本部長
常務執行役員	林　伸一	第三開発生産本部長 東京エレクトロン九州㈱ 代表取締役社長・テクノロジーオフィサー
常務執行役員	神永　文彦	グローバルセールス本部副本部長
常務執行役員	川本　弘	グローバルビジネスプラットフォーム本部副本部長、ファイナンスユニットGM
執行役員	石田　博之	ES BUGM
執行役員	多田　新吾	アカウントセールス本部副本部長、アカウントGM
執行役員	守田　雅博	アカウントGM、グローバルセールス本部GM
執行役員	峰島　孝之	ITユニットGM、業務改革プロジェクトサブリーダー
執行役員	鷲尾　康裕	CTSPS BUGM
執行役員	中谷　茂樹	TFF BUGM
執行役員	瀬川　澄江	コーポレートイノベーション本部本部長代理
執行役員	阿曽　達也	法務コンプライアンスユニットGM、人事総務ユニットGM
執行役員	石田　寛	DSS BUGM
執行役員	堂　和寛	戦略担当GM
執行役員	神原　弘光	第二開発生産本部長 東京エレクトロン宮城㈱ 代表取締役社長
執行役員	樋口　公博	ES 副BUGM、SPE事業本部本部長補佐
執行役員	日向　邦彦	東京エレクトロン宮城㈱ テクノロジーオフィサー
執行役員	大庭　誠	アカウントGM
執行役員	長谷部　一秀	東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱ テクノロジーオフィサー
執行役員	両角　友一朗	第一開発生産本部長 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱ 代表取締役社長
執行役員	吉澤　正樹	グローバルビジネスプラットフォーム本部本部長補佐

（注）表中に使用しております用語の説明は、次のとおりであります。
SPE　:半導体製造装置
DSS　:ダイバースシステムズ＆ソリューションズ
ES　:エッチングシステム
CTSPS　:クリーントラック・サーフェスプレパレーションシステム
TFF　:シンフィルムフォーメーション
BU　:ビジネスユニット
GM　:ジェネラルマネージャー

③ 取締役及び監査役の報酬等の額

区分	対象となる役員の員数（名）	報酬等の総額（百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）					
			固定基本報酬	年次業績連動報酬		中期業績連動報酬	非業績連動報酬	
				現金賞与（注）1	株式報酬型ストックオプション（注）2、5	パフォーマンスシェア（株式報酬）（注）3、5	株式報酬型ストックオプション（注）2、5	リストリクテッド・ストック・ユニット（株式報酬）（注）4、5
取締役（社外取締役を除く）	8	2,193	232	531	807	15	606	
社外取締役	3	69	55					14
取締役合計	11	2,263	287	531	807	15	606	14
監査役（社外監査役を除く）	3	89	89					
社外監査役	3	45	45					
監査役合計	6	135	135					

（ご参考）当事業年度に係る当社代表取締役の個別報酬等

会社における地位及び氏名（注）7	報酬等の総額（百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）				
		固定基本報酬	年次業績連動報酬		中期業績連動報酬	非業績連動報酬
			現金賞与（注）8	株式報酬型ストックオプション（注）5、9	パフォーマンスシェア（株式報酬）（注）3、5	株式報酬型ストックオプション（注）5、9
代表取締役社長　河合　利樹	1,380	108	310	631	6	324
代表取締役副社長　佐々木　貞夫	552	69	141	164	2	174

（注）1. 2024年6月18日開催予定の第61期定時株主総会において付議する賞与額を記載しております。
2. 2024年6月18日開催予定の第61期定時株主総会において付議する新株予約権の上限に相当する額を記載しております。
3. 当事業年度において費用計上した額を記載しております。なお、中期業績連動報酬に関しましては、対象期間（3事業年度）における業績目標達成度に応じた支給率により変動します。
4. 当事業年度において費用計上した額を記載しております。なお、非業績連動の株式報酬に関しましては、対象期間（3事業年度）終了後に株式を交付します。
5. 非金銭報酬であり、その内容については「④会社役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」に記載のとおりです。
6. コーポレートオフィサー兼務取締役及び執行役員兼務取締役に対しては、取締役報酬のみを支給し、コーポレートオフィサー及び使用人分給与は別途支給しておりません。
7. 当事業年度末時点における代表取締役2名に関する当事業年度に係る個別報酬を記載しております。
8. 2024年6月18日開催予定の第61期定時株主総会において付議する賞与額のうち、各代表取締役に支給予定の額を記載しております。

9. 2024年6月18日開催予定の第61期定時株主総会において付議する新株予約権の上限に相当する額のうち、各代表取締役に付与予定の新株予約権に相当する額を記載しております。
10. 監査役（社外監査役を除く）に対する固定基本報酬の対象者については、2023年6月20日開催の第60期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名、及び取締役（社外取締役を除く）に対する中期業績連動報酬の対象者については、2022年6月21日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名をそれぞれ含んでおります。
11. 当事業年度に係る代表取締役の個人別の報酬額については、「④会社役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」に基づいていることを報酬委員会において検証の上、取締役会においても確認しました。また、当事業年度に係る代表取締役を除く取締役の固定基本報酬額及び年次業績連動報酬額は、取締役会から委任を受け、業務執行を統括する代表取締役社長・CEO河合利樹が決定しました。なお、CEOが各取締役の報酬額を決定するに際しては、外部調査機関が提供する業界の国内外企業の報酬水準を参照し、外部専門家からの助言を得るとともに、報酬委員会において金額の妥当性を検証しております。

④ 会社役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、報酬委員会の審議を経て、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。

■報酬の基本方針

当社グループの役員報酬の基本方針として重視する点は以下のとおりであります。
①グローバルに優秀な経営人材を確保できるための競争力のある水準と制度
②短期的業績及び持続的な成長に向けた中長期の企業価値向上との高い連動性
③報酬決定プロセスの透明性・公正性、報酬の妥当性の確保

■報酬構成

取締役のうち、社内取締役の報酬は、中長期的な企業価値向上をより強く意識づけるために2024年3月期より年次業績連動報酬における株式報酬の比率を増やし、また、その一部を非業績連動報酬（株式報酬）としたことにより、次頁の表のとおり「固定基本報酬」「年次業績連動報酬」「中期業績連動報酬」「非業績連動報酬（株式報酬）」で構成されます。

社外取締役につきましては、経営の監督に加えて、中長期的な企業価値向上の視点から経営に対して助言をおこなうという役割を担っております。この期待役割に対しより整合した報酬体系とすることを目的に、非業績連動の株式報酬制度を導入しており、社外取締役の報酬は「固定基本報酬」「非業績連動報酬（株式報酬）」で構成されます。

監査役の報酬については、経営の監査・監督が主たる役割であることを踏まえ、「固定基本報酬」のみとしております。

報酬の種類		社内取締役	社外取締役	監査役	報酬の概要
①固定基本報酬		○	○	○	・社内取締役については外部専門機関(注)の職務等級フレームワークを参照し、職責の大きさに応じて設定
② 年次業績 連動報酬	現金賞与	○	—	—	・事業年度ごとの業績向上への意識を高めること等を目的に、当年度の業績に連動して支給 ・現金賞与と株式報酬型ストックオプションで構成 ・年次業績連動報酬と非業績連動報酬の合計の現金賞与対株式報酬型ストックオプションの割合は、職責に応じて、概ね3対7から4対6 ・具体的な支給額・付与個数は当年度の会社業績と個人パフォーマンスの評価結果に応じて決定 － 会社業績の評価指標は、親会社株主に帰属する当期純利益及び連結ROEを採用し、営業利益率・営業利益成長率の競合企業との比較結果を支給額に反映 － 個人パフォーマンスの評価項目には、ESG等を含む短期及び中期経営戦略目標に対する貢献度を含む ・株式報酬型ストックオプションには、中長期にわたり株主目線の共有及び企業価値増大への意識を高めることを目的に、権利付与から3年間の権利行使制限期間を設定
	株式報酬型 ストック オプション	○	—	—	
③ 中期業績 連動報酬	パフォーマンス シェア （株式報酬）	○	—	—	・中期の業績向上への意識を高めること等を目的に支給 ・支給率が100%の場合、支給額は職責に応じて固定基本報酬の30%～100%程度に設定 ・対象期間（3事業年度）における業績目標達成度に応じて交付株式数を決定 ・業績評価指標には、連結営業利益率と連結ROEを採用
④ 非業績 連動報酬	株式報酬型 ストック オプション	○	—	—	・中長期の企業価値向上への意識を高めること等を目的に支給 ・支給額は、職責に応じて、固定基本報酬の概ね2～3倍の範囲で設定 ・中長期にわたり株主目線の共有及び企業価値増大への意識を高めることを目的に、権利付与から3年間の権利行使制限期間を設定
	リストリクテッド・ ストック・ ユニット （株式報酬）	—	○	—	・中長期的な企業価値向上の視点から経営に対して助言をおこなうという期待役割に対しより整合した報酬体系とすることを目的に支給 ・現金報酬と株式報酬を適切なバランスで支給するべく、支給額を固定基本報酬の50%～60%程度に設定 ・対象期間（3事業年度）終了後に株式を交付

（注）外部専門機関：ウイリス・タワーズワトソン

■報酬の構成割合

当社グループの社内取締役の報酬構成は、短期的業績及び持続的な成長に向けた中長期の企業価値向上との高い連動性をもつ設計となっております。また、株主目線を共有し、企業価値増大への意識を高めることを目的に、報酬の一部を株式で付与しています。

<参考>当事業年度のCEOの報酬構成割合

■報酬等の種類別の方針及び決定方法

❶ 固定基本報酬

固定基本報酬は、国内外企業の報酬水準を参照した上で、社内取締役については外部専門機関の職務等級フレームワークを参照し、職責の大きさに応じて設定しております。

取締役の固定基本報酬につきましては、株主総会で決議された固定基本報酬限度額の範囲内で決定します。代表取締役の報酬額は、報酬委員会からの提案に基づき取締役会で協議・決定し、代表取締役を除く取締役の報酬額は、取締役会の決議に基づきCEOが決定しています。なお、取締役の報酬額の決定にあたっては、外部調査機関が提供する国内外企業の報酬水準を参照し、外部専門家からの助言も得た上で、社内取締役については職務等級フレームワークに基づく職責の大きさに応じて決定しております。また、外部専門家からの助言を参照の上、報酬委員会においても金額の妥当性を検証しております。

監査役の固定基本報酬については、株主総会で決議された固定基本報酬限度額の範囲内で監査役の協議に基づき決定しております。

❷ 年次業績連動報酬

《構成・固定基本報酬に対する支給割合に関する方針》

年次業績連動報酬は、取締役のうち社内取締役のみを対象としており、当年度の業績に連動して支給され、原則、現金賞与と株式報酬型ストックオプションで構成します。なお、総報酬から固定基本報酬及び中期業績連動報酬を除く部分（すなわち年次業績連動報酬と非業績連動報酬の合計部分）について、現金賞与対株式報酬型ストックオプションの割合は、職責に応じて、概ね3対7から4対6としております。また、株式報酬型ストックオプションにつきましては、権利付与から3年間の権利行使制限期間を設定し、中長期にわたり株主目線の共有及び企業価値増大への意識を高める仕組みとしています。

なお、年次業績連動報酬は事業年度ごとの業績に応じた利益配分型を基本とした報酬となっており、固定基本報酬に対する支給割合に関する方針は設定しておりません。

《算定指標・当該指標を選択した理由》

代表取締役を含む取締役の会社業績に対するインセンティブとして、利益の状況を示す指標の中から親会社株主に帰属する当期純利益の実績値を算定指標として採用しております。また、資本効率を示す指標である連結ROEの実績値を算定式に組み込んでおります。

《算定方法・決定方法》

・代表取締役

代表取締役の年次業績連動報酬額については、親会社株主に帰属する当期純利益及び連結ROEを業績評価指標とする算定式により算出された数値に対し、競合企業との営業利益率・営業利益成長率の比較及び、代表取締役個人パフォーマンス評価（ESG等を含む短期及び中期経営戦略に基づく目標）を反映した金額案を外部専門家からの助言も踏まえ、報酬委員会において審議します。報酬委員会は、審議結果を取締役会に提案し、取締役会は当該提案を検討の上、最終的な報酬額を決定しております（下表参照）。

＜報酬額決定に係る報酬委員会の役割＞

ミッション（評価項目）の設定	パフォーマンス評価	報酬額の決定
報酬委員会による審議及び代表取締役を除く取締役会メンバー（クローズドセッション）による審議を経て設定	報酬委員会による審議を経て、代表取締役を除く取締役会メンバー（クローズドセッション）により評価	報酬委員会が支給額を取締役会に提案し、取締役会決議により決定

・取締役（代表取締役及び社外取締役を除く）

親会社株主に帰属する当期純利益及び連結ROEに連動する各取締役の年次業績連動報酬額は、取締役会の決議に基づき、株主総会で決議された賞与額の範囲内でCEOが決定しています。決定にあたっては、外部調査機関が提供する業界の国内外企業の報酬水準を参照し、営業利益率・営業利益成長率の競合企業との比較及び各取締役の職責とパフォーマンス評価（ESG等を含む短期及び中期経営戦略に基づく目標）を反映しております。また、各取締役の報酬額は、外部専門家からの助言を参照した上で報酬委員会においても妥当性の検証を実施しております。

❸ 中期業績連動報酬

《構成・固定基本報酬に対する支給割合に関する方針》

中期業績連動報酬は、取締役のうち社内取締役のみを対象としており、パフォーマンスシェア（株式報酬）として支給します。中期の業績向上への意識を高めるとともに、株式保有を通して

株主目線を共有することで企業価値増大への意識を高めること等を目的としています。交付される当社株式の数は、各人の職責及び対象期間（3事業年度）における業績目標の達成度に応じて変動します。

中期業績連動報酬の支給率が100％の場合、支給額は職責に応じて固定基本報酬の30％～100％程度に設定しております。

《算定指標・当該指標を選択した理由》

中期業績連動報酬につきましては、当社の中期経営計画と連動する形で、収益力を測る指標として連結営業利益率を採用し、また、資本効率を示す指標として連結ROEを採用しております。

《算定方法・決定方法》

（中期業績連動報酬算定式）

株式交付ポイント ＝ 基準ポイント（職責の大きさに応じて設定）×70％×連結営業利益率連動係数（※） ＋ 基準ポイント（職責の大きさに応じて設定）×30％×連結ROE連動係数（※）

（※）対象期間（3事業年度）の業績目標の達成度を評価する指標は、連結営業利益率・連結ROEそれぞれ対象期間における最終事業年度の実績値とします。各連動係数は、業績目標の達成度に応じて、2021年プランは、支給率0％・50％・75％・100％・120％の5段階、2022・2023年プランは、支給率0％・50～120％の範囲とします。

社内取締役に対して交付される当社株式の数は、上記算定式に従って算出される株式交付ポイント数に応じ、1ポイントにつき当社株式1株とします。ただし、当社株式について分割、無償割当または併合等があった場合は、1ポイント当たりに交付がおこなわれる株式数を調整します。

なお、算定式また算定式に用いる基準ポイント及び業績連動係数については報酬委員会からの提案に基づき取締役会が決定します。

❹ 非業績連動報酬

社内取締役を対象とする非業績連動の株式報酬制度（株式報酬型ストックオプション）は、中長期の企業価値向上への意識を高めること等を目的に導入しており、支給額は、職責に応じて、固定基本報酬の概ね2～3倍の範囲で設定しております。

また、当社の社外取締役は、経営の監督に加えて、中長期的な企業価値向上の視点から経営に対して助言をおこなうという役割を担っており、この期待役割に対しより整合した報酬体系とすることを目的に非業績連動の株式報酬制度（リストリクテッド・ストック・ユニット）を導入しております。支給額につきましては、現金報酬と株式報酬を適切なバランスで支給するべく、固定基本報酬の50％～60％程度に設定しており、対象期間（3事業年度）終了後に株式を交付します。

社外取締役に対して交付される当社株式の数は、支給額をもとに算出される株式交付ポイント数に応じ、1ポイントにつき当社株式1株とします。ただし、当社株式について分割、無償割当または併合等があった場合は、1ポイント当たりに交付がおこなわれる株式数を調整します。

＜参考＞株式報酬型ストックオプション（年次業績連動報酬及び非業績連動報酬）支給イメージ

■当事業年度に係る会社役員の報酬等についての株主総会決議に関する事項

区分	報酬区分	株主総会の決議年月日	当該決議の内容の概要	当該決議に係る会社役員の員数(注)
取締役	固定基本報酬	2011年6月17日開催の第48期定時株主総会	1事業年度につき総額7億5,000万円以内（うち社外取締役分、1事業年度につき3,000万円以内）	取締役15名（うち社外取締役2名）
		2021年6月17日開催の第58期定時株主総会	1事業年度につき総額7億5,000万円以内（うち社外取締役分、1事業年度につき1億円以内）	取締役12名（うち社外取締役4名）
	年次業績連動報酬	2024年6月18日開催の第61期定時株主総会（予定）	現金賞与部分として、総額5億3,180万円を支給	取締役3名（社外取締役3名を除く）
			株式報酬型ストックオプション部分として、総額8億790万円、総数246個（24,600株）の範囲内で新株予約権を付与	取締役3名（社外取締役3名を除く）
	中期業績連動報酬	2018年6月19日開催の第55期定時株主総会	3事業年度を対象として対象期間ごとに4億8,000万円を上限とする信託金を拠出し、対象期間ごとに71,400株を上限とする当社株式を交付	取締役9名（社外取締役3名を除く）
	非業績連動報酬	2024年6月18日開催の第61期定時株主総会（予定）	株式報酬型ストックオプション部分として、総額6億600万円、総数185個（18,500株）の範囲内で新株予約権を付与	取締役3名（社外取締役3名を除く）
		2020年6月23日開催の第57期定時株主総会	株式報酬制度として、3事業年度を対象として対象期間ごとに5,000万円を上限とする信託金を拠出し、対象期間ごとに15,000株を上限とする当社株式を交付	社外取締役3名
監査役	固定基本報酬	2011年6月17日開催の第48期定時株主総会	月額1,300万円以内（年額1億5,600万円以内）	監査役4名

（注）当該株主総会終結時点の各報酬等の対象となる役員の員数です。

■当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

・年次業績連動報酬

年次業績連動報酬は、「■報酬等の種類別の方針及び決定方法」に記載の算定方法に従い、親会社株主に帰属する当期純利益及び連結ROEの実績値を算定指標としますが、利益配分型を基本とした報酬であるため、指標の目標は設定しておりません。

なお、当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益は3,639億6千3百万円、連結ROEは21.8%であります。

・中期業績連動報酬

中期業績連動報酬は、「■報酬等の種類別の方針及び決定方法」に記載の算定方法に従い、付与時点の中期経営計画に基づく連結営業利益率及び連結ROEを指標の目標としております。2021年設定プランの目標達成度を評価する指標である2024年3月期の実績は、連結営業利益率24.9%、連結ROE21.8%となり、目標値には届きませんでした。

なお、2022年、2023年設定プランは対象期間における最終事業年度の業績により支給率を決定いたします。そのため、実績について現時点では確定しておりません。

■株式保有ガイドライン

当社は、経営陣が持続的な企業価値の向上とステークホルダーとの利益の共有をより確かなものとするため、株式保有ガイドラインを導入しております。本ガイドライン（2021年7月1日発効）は、発効後または就任後5年以内に、以下の価値に相当する当社株式を保有することを目標としています。

CEO	社内取締役 コーポレートオフィサー	社外取締役	当社執行役員
固定基本報酬（年額）の3倍	固定基本報酬（年額）の2倍	固定基本報酬（年額）の1倍	固定基本報酬（年額）の1倍

■クローバックポリシー

当社は、業務執行取締役の故意の不正行為を主因として、財務数値の重大な修正が必要となると認められる場合に、業績連動報酬の返還を要求することができるクローバックポリシーを導入しております。返還の対象となり得る報酬は、該当行為が認められた事業年度及びその前の3事業年度において受け取った業績連動報酬のうち過大な部分です。本ポリシー（2021年7月1日発効）は、2022年3月期を対象とする年次業績連動報酬及び2022年3月期中に付与された中期業績連動報酬からその適用対象となり、以後すべての期間において適用されます。

■報酬委員会の役割

当社は、経営の透明性・公正性、報酬の妥当性を確保するため、社外取締役を含む3名以上の取締役（代表取締役を除く）で構成される報酬委員会を設置しております。当事業年度の報酬委員会は、社外取締役2名、社内取締役1名の計3名で構成され、社外取締役が委員長を務めております。報酬委員会の開催にあたっては外部専門家が毎回同席しており、この外部専門家からの助言を活用し、国内外企業との報酬水準等の比較、国内外における最新動向やベストプラクティス（ESG指標の報酬への反映など）の分析をおこなった上、当社の報酬の基本方針に照らし、当社グループに最も適切な報酬制度、代表取締役の個別報酬額等について、取締役会に提案をおこなっております。

⑤ 社外役員に関する事項

❶ 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係（2024年3月31日現在）

区 分	氏 名	重要な兼職の状況	当社との関係
社外取締役	佐々木　道夫	㈱SHIFT 取締役副社長	重要な取引関係はありません。
社外取締役	江田　麻季子	住友商事㈱ 常務執行役員 富士フイルムホールディングス㈱ 社外取締役	重要な取引関係はありません。
社外取締役	市川　佐知子	田辺総合法律事務所 パートナー オリンパス㈱ 社外取締役 公益社団法人会社役員育成機構 理事	重要な取引関係はありません。
社外監査役	和貝　享介	和貝公認会計士事務所 所長 持田製薬㈱ 社外監査役	重要な取引関係はありません。
社外監査役	濵　正孝	ニッセイアセットマネジメント㈱ 社外取締役	重要な取引関係はありません。
社外監査役	三浦　亮太	弁護士法人三浦法律事務所 パートナー テクマトリックス㈱ 社外取締役（監査等委員） エーザイ㈱ 社外取締役	重要な取引関係はありません。

❷ 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況 (注)	
社外取締役	佐々木　道夫	取 締 役 会：10回中10回に出席 指名委員会：10回中10回に出席 報酬委員会：9回中9回に出席	取締役会において、製造業等での経営経験に基づき、特に中長期的な製品戦略や開発投資、情報セキュリティリスクに関して、積極的な発言をおこなっております。また、指名委員会では委員長を務め、取締役候補者の選定に係る事項等について、客観的・中立的な立場から審議を主導しております。報酬委員会では委員として、取締役の報酬に係る事項等について、客観的・中立的な立場から発言をおこなっております。
社外取締役	江田　麻季子	取 締 役 会：10回中10回に出席 報酬委員会：9回中9回に出席	取締役会において、半導体業界におけるマーケティング分野の専門的見地及びグローバルで多面的な視点から、特に中長期的な成長戦略や人材戦略、地政学リスクに関して、積極的な発言をおこなっております。また、報酬委員会では委員長を務め、取締役の報酬に係る事項等について、客観的・中立的な立場から審議を主導しております。
社外取締役	市川　佐知子	取 締 役 会：10回中10回に出席 指名委員会：10回中10回に出席	取締役会において、日米の弁護士及び米国公認会計士としての幅広い見識に基づき、特に取締役会の監督機能の強化などのコーポレートガバナンス、財務会計やリスクマネジメント全般に関して、積極的な発言をおこなっております。また、指名委員会では委員として、取締役候補者の選定に係る事項等について、客観的・中立的な立場から発言をおこなっております。
社外監査役	和貝　享介	取 締 役 会：10回中10回に出席 監 査 役 会：9回中9回に出席	取締役会及び監査役会において、公認会計士としての専門的見地から、議案審議等に必要な発言を適宜おこなっております。
社外監査役	濵　　正孝	取 締 役 会：10回中10回に出席 監 査 役 会：9回中9回に出席	取締役会及び監査役会において、金融業界における長年の幅広い経験及び財務会計に関する知見を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜おこなっております。
社外監査役	三浦　亮太	取 締 役 会：10回中9回に出席 監 査 役 会：9回中9回に出席	取締役会及び監査役会において、弁護士としての専門的見地から、議案審議等に必要な発言を適宜おこなっております。

（注）社外取締役に期待される役割に関しておこなった職務の概要を含みます。

3. 会社の体制及び方針

剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、利益成長を通じて企業価値向上を図るべく、内部留保資金を有効活用し、成長分野に重点的に投資するとともに、業績連動型配当により、株主各位に対して直接還元してまいります。

■株主還元策

当社の配当政策は業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50％を目処とします。ただし、1株当たりの年間配当金は50円を下回らないこととします。なお、2期連続で当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討します。

また、自己株式の取得については、機動的に実施を検討します。

当事業年度の期末配当につきましては、上記方針を適用し1株当たり245円とさせていただき、支払開始日を2024年5月29日といたしました。これにより、年間配当金は、中間配当金148円を含め1株当たり393円となります。

また、当事業年度において、自己株式1,199億円を取得いたしました。

配当金の推移

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。2020年3月期から2023年3月期の配当金につきましては、2020年3月期の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しております。

連結計算書類

連結貸借対照表

（単位：百万円）

科目 ＼ 期別	第60期（2023年3月31日現在）	第61期（2024年3月31日現在）
資産の部		
流動資産	**1,740,959**	**1,700,451**
現金及び預金	473,099	462,383
受取手形、売掛金及び契約資産	464,889	391,423
有価証券	0	10,165
商品及び製品	236,795	284,451
仕掛品	161,938	173,929
原材料及び貯蔵品	253,474	304,576
その他	150,946	73,876
貸倒引当金	△184	△353
固定資産	**570,634**	**756,011**
有形固定資産	**259,088**	**337,366**
建物及び構築物	117,896	133,970
機械装置及び運搬具	51,510	60,261
土地	31,283	33,804
建設仮勘定	39,605	87,399
その他	18,792	21,931
無形固定資産	**28,559**	**32,383**
その他	28,559	32,383
投資その他の資産	**282,986**	**386,260**
投資有価証券	165,507	277,706
繰延税金資産	58,599	42,096
退職給付に係る資産	19,374	29,426
その他	40,844	38,441
貸倒引当金	△1,340	△1,409
資産合計	**2,311,594**	**2,456,462**

科目 ＼ 期別	第60期（2023年3月31日現在）	第61期（2024年3月31日現在）
負債の部		
流動負債	**629,893**	**611,899**
支払手形及び買掛金	116,317	92,359
未払法人税等	71,177	80,009
前受金	289,169	289,905
賞与引当金	43,337	43,727
製品保証引当金	34,382	33,524
その他	75,509	72,372
固定負債	**82,175**	**84,383**
退職給付に係る負債	60,366	56,139
その他	21,808	28,243
負債合計	**712,069**	**696,282**
純資産の部		
株主資本	**1,433,141**	**1,478,063**
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	1,322,203	1,480,306
自己株式	△22,033	△135,215
その他の包括利益累計額	**154,453**	**268,771**
その他有価証券評価差額金	107,452	184,934
繰延ヘッジ損益	△46	42
為替換算調整勘定	43,091	72,275
退職給付に係る調整累計額	3,954	11,519
新株予約権	**11,929**	**13,345**
純資産合計	**1,599,524**	**1,760,180**
負債純資産合計	**2,311,594**	**2,456,462**

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

（単位：百万円）

科目 ＼ 期別	第60期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）	第61期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
売上高	**2,209,025**	**1,830,527**
売上原価	1,224,617	1,000,257
売上総利益	**984,408**	**830,269**
販売費及び一般管理費	366,684	374,006
営業利益	**617,723**	**456,263**
営業外収益	**10,066**	**12,164**
受取利息	1,235	2,567
持分法による投資利益	2,968	3,388
補助金収入	2,559	2,430
その他	3,303	3,778
営業外費用	**2,604**	**5,242**
為替差損	1,401	4,148
その他	1,202	1,094
経常利益	**625,185**	**463,185**
特別利益	**890**	**10,838**
固定資産売却益	890	10,617
その他	—	220
特別損失	**1,219**	**584**
固定資産除売却損	781	584
減損損失	438	—
税金等調整前当期純利益	**624,856**	**473,439**
法人税、住民税及び事業税	173,704	124,001
法人税等調整額	△20,431	△14,525
法人税等合計	**153,272**	**109,475**
当期純利益	**471,584**	**363,963**
親会社株主に帰属する当期純利益	**471,584**	**363,963**

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会　毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日	期末配当　毎年3月31日 中間配当　毎年9月30日
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
（郵送物送付先）	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
（電話照会先）	0120-782-031
公告方法	電子公告 https://www.tel.co.jp/ir/stocks/koukoku/ ただし、電子公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
上場金融商品取引所	東京証券取引所　プライム市場 （証券コード　8035）

（ご参考）半導体製造プロセス

半導体は、テレビやPC、スマートフォンなどのデジタル製品の基幹部品です。また、スマート工場、農業、医療、スマートシティなど、あらゆる産業のデジタル化を支えています。当社は、半導体を「つくる」ための装置の開発、製造・販売、技術サポートまでをおこなっています。

成膜

Thermal Processing System
TELINDY PLUS™

Single Wafer Deposition System
Triase+™

Atomic Layer Deposition System
NT333™

リソグラフィー（フォトレジスト塗布・現像）

Coater/Developer
CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z

繰り返し

酸化膜形成・窒化膜形成

酸化、CVD*、あるいは ALD** 法などを用いて、清浄なウェーハ上に薄膜（シリコン酸化膜、シリコン窒化膜など）を堆積、成膜します。

＊CVD：Chemical Vapor Deposition（化学気相成長）
＊＊ALD：Atomic Layer Deposition（原子層堆積）

フォトレジスト*塗布

ウェーハを高速回転させながら、フォトレジストをウェーハ全面に薄く、均一に塗布します。

＊フォトレジスト：UV 光により性質変化が起こる感光材料

露光

IC パターンを描いたフォトマスクをウェーハに合わせ、露光装置で UV 光を照射し、フォトレジストにパターンを転写します。

現像

露光されたフォトレジストを現像液で溶かします。これにより、使用したフォトマスクに応じたパターンがウェーハ上に残ります。

素子分離形成・ゲート形成

検査

Wafer Prober
Prexa™ / Cellcia™

完成された集積回路の一つひとつに検査針を当て良・不良判定をおこないます。

ウェーハ検査

再配線形成

Coater/Developer
CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ AP

Thermal Processing System
TELINDY PLUS™

Passivation film coating

Passivation film Developing

再配線や接合パッド（バンプ）の形成や保護をするために、ポリイミドのような高粘度材料を塗布、及び現像処理をおこないます。その後熱硬化処理をおこないます。

不活性膜塗布・現像

集積回路の完成

ウェーハ処理プロセス（前工程）　検査・組み立てプロセス（後工程）

エッチング

Plasma Etch System
Tactras™ / Episode™ UL

エッチング

プラズマエッチング装置で、フォトレジスト上に現像されたパターンに従って、成膜されたシリコン酸化膜・シリコン窒化膜・シリコンなどを削り取ります。

洗浄

Single Wafer
Cleaning System
CELLESTA™-*i*

レジスト剥離・洗浄

エッチング後に不要になったフォトレジストを除去します。また、洗浄装置でウェーハを薬液に浸して、不純物を除去します。

**配線前の
トランジスタ（素子）の
完成**

ゲート電極

配線形成

Single Wafer
Deposition System
Triase+™

Plasma Etch System
Tactras™ / Episode™ UL

個別トランジスタをつなぐ配線を形成するため、ゲート上に層間絶縁膜を堆積・成膜し上下パターンの分離をおこないます。接続孔（コンタクトホール）をつくり、CVD 法で金属膜を埋め込みます。

コンタクト形成

上下パターンの分離のため絶縁膜を堆積し、配線溝パターンをつくります。その溝（トレンチ）に金属膜を埋め込み、余分な膜を研磨・除去します。これを配線階層分繰り返します。

多層配線形成

パッケージング・検査

Wafer Bonder/
Debonder
Synapse™ V/
Synapse™ Z Plus

再配線層や接合パッド（バンプ）を形成後、ウェーハを支持基板に貼り合わせ、裏面を薄化する場合もあります。その後、支持基板をデボンディング装置により剥離します。

支持基板貼り合わせ・剥離

Wafer/Dicing Frame Prober
WDF™ 12DP+

ウェーハから切り出されたチップ一つひとつに対し、良・不良判定をおこないます。

検査

良品チップをパッケージ基盤、またはリードフレームに接続し、セラミック樹脂などに封入します。

**半導体パッケージングの
完成**

パッケージング・組み立て

TOKYO ELECTRON

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。